

機関投資家・メディア向け 2020 年 3 月期第 2 四半期決算説明会 質疑応答（要旨）

- ◇ 日時：2019 年 11 月 27 日 15:30-17:00
- ◇ 場所：グラントーキョーノースタワー18F 大和コンファレンスルーム

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス

記

Q1: 中口径 8 インチ (200mm) ウェーハのインゴット（銀川）、ポリッシュドウェーハ（上海、杭州）の現在の歩留まり状況について教えてください。

A1: 現在、中国の銀川工場で生産しているインゴット歩留まり（最終合格率）は、60-65%程度です。また、上海工場で生産しているポリッシュドウェーハの歩留まりは、約 95%です。杭州新工場の試作ラインの歩留まりは現在、91~92%程度ですが、今後量産への移行に伴い、更に改善されていく見通しです。

Q2: 現在、中口径 8 インチ (200mm) ウェーハの需要が軟化しているように思いますが、最終的にフェローテックが目標としている月産 45 万枚の供給能力が余剰になる可能性はないでしょうか？

A2: 当社では、最終的に月産 45 万枚の生産体制を目標としています。その際の販売については、中国市場で月産 20~25 万枚、中国外の海外市場で同じく、20~25 万枚程度を想定しています。2019 年時点の中国市場の需要は月産 90 万枚程度であります。今後はデバイスメーカーの増産が重なる事から、月産 150~180 万枚程度の需要が出てくるものと想定されます。また、中国市場は現在、ウェーハ需要の大半を中国外から輸入している事を考えると、国産化流れが加速することに伴い、当社の中国市場への販売量も確保される可能性が高く、当社の合計生産能力に見合った販売の確保はグローバルで可能だと考えています。

尚、8 インチ、及び大口径 12 インチ (300mm) ウェーハの技術的水準（参入障壁）は非常に高い事から、中国国内で良質なインゴット、及びポリッシュドウェーハを生産できる当社の優位性は高いと考えています。

Q3: 8インチと比較しても、大口径 12インチ(300mm)ウェーハの技術水準は高いと思います。現在の試作の状況と、今後の販売先やアプリケーションについて教えて下さい。また、第一期の試作ライン月産3万枚の次となる、第二期月産7万枚の追加投資はどの程度の投資金額を考えているのでしょうか？

A3: 12インチについて、現在銀川で生産しているインゴットの試作品の評価は上々です。今後、杭州のウェーハ工場、ポリッシュドウェーハの試作、認定を行ってまいります。中国市場をメインターゲットとして考えており、先ず当社がターゲットとするウェーハ需要は、中国国内のパワーデバイスメーカー向けの需要です。その次のステップでは、ウェーハの規格として難易度の高い、COP (Crystal Originated Particle) フリーを満たしたライトドープのウェーハ需要も取りこんでいく計画です。

尚、12インチウェーハは、8インチと比較しても、中国国内で内製化出来るメーカーが少ないことから、国産化へ向けた国内需要の高まりが期待できます。

12インチウェーハの第二期として想定する月産7万枚の追加投資を実行する場合には、当社としては、今のところ100~150億円程度の追加の資金調達が必要になると想定しています。それ以外の費用については、中国政府からの優遇政策を含め、出来るだけ外部の資金をあてがう事を想定しております。

Q4: 石英など、半導体製造装置向け治具、消耗材の需要に関連する内容ですが、2019年は、半導体デバイスメーカーの稼働調整が入りました。現在は韓国大手メーカーの在庫調整もかなり進んできた印象が有りますが、メモリー系デバイスメーカーを中心に、今後の需要回復の見通しについてどのように見えていますか？

A4: 中国市場では、メモリー系 3D-NAND の YMTC、メモリー系 DRAM の CXMT、ロジック系ファンドリーの Huali などの半導体デバイスメーカーの投資が旺盛になってきています。メモリー系全般でも回復基調となってきたことから、2020年第1四半期(1-3月)以降も半導体製造装置メーカーの需要が回復してくるとみております。この為、当社も製造装置メーカーやデバイスメーカー向けに部材の増産対応をしていく必要が出てくると見えています。尚、半導体製造装置設備投資の市場規模については、2020年は2018年までの回復には至らないものの、2019年比較で見るとやや回復すると見ており、2021年にはまた大幅な伸びを示す可能性が高いと見えています。

Q5: 電子デバイスセグメントのサーモジュールを中心に、今後の需要拡大に関連する内容ですが、次世代通信規格である 5G 市場の今後の見通しについて教えてください。

A5: 中国の通信機器メーカーの 5G 通信基地局需要の影響で、2020 年 3 月期上期についても、当社のサーモジュールへの需要が伸びています。中国の通信機器メーカーの 5G 基地局の設置は、中国以外にも、今後、アフリカ、南アメリカ、欧州などで拡大していく見通しです。この為、2019 年の 5G 向け需要は、2023 年には 3~4 倍まで拡大する可能性があります。5G 需要のピークは、2022 年~2023 年とみていますが、その需要は、2025 年頃までは継続する見通しです。尚、2021 年 3 月期の 5G 向けサーモジュールの売上増は、前年比で 1.3~1.5 倍程度を想定しております。

Q6: 2021 年 3 月期以降の設備投資額、減価償却費の見通しについて教えてください。今後、大口径ウエーハの事業拡大を進めると思いますが、減価償却費のピークはどの程度の規模を想定されているのかについても教えてください。

A6: 設備投資額について、2020 年 3 月期は、投資時期の期ズレにより、年初計画の 480 億円を 400 億円に減額修正しました。また、2021 年 3 月期は、今のところ前期の期ズレ分以外に 110 億円規模を想定していますが、今後精査が必要です。

減価償却費について、2020 年 3 月期は、年初計画の 80 億円を 70 億円に減額修正しました。また、2021 年 3 月期は、今のところ 110 億円規模を想定しています。尚、減価償却費のピークは、2022 年 3 月期、ないし 2023 年 3 月期になると考えていますが、その規模は、※135~145 億円程度が想定されますが、これについても設備投資額同様に今後精査が必要です。

※ 本質疑応答では、ピーク時の減価償却費を 250 億円程度と回答致しましたが、この数値は誤りでございました。弊社としては今のところ、ピーク時の減価償却費を 135~145 億円程度と想定しております。本訂正を持って正式な回答とさせていただきます。何卒ご了承ください。

Q7: 今後の事業拡大や成長路線を勘案すると、更なる借入金の増大が避けられない状況だと思います。バランスシートの悪化も懸念される事から、今後の資金調達の方針について教えてください。また借入金の返済については、今後問題にはならないでしょうか？

A7: 8/12 インチのウェーハ設備投資については、一部資金調達が必要なものもございますが、ほぼ見通しが立っています。また、当社としては、今後も成長資金は調達の必要がございます。これについては、これまでのように、借入金中心でまかなうのではなく、スキームを多様化させる事を検討しています。具体的には、極力各プロジェクトの資本提携パートナーを選定し、中国政府の資金的なサポートも最大限活用し、また中国などの海外の資本市場での調達も検討しながら有効活用した上での資金調達も視野に入れていきたいと考えています。

尚、当社では今後、石英、部品洗浄、パワー半導体基板、サーモモジュールなど、成長を期待できる事業ポートフォリオを多く保有している事から、営業キャッシュフローに水準に鑑みて、借入金の返済に問題はないものと考えています。

Q8: 8インチウェーハは、台湾の GlobalWafers と販売提携をし、技術の供与も受けています。今回、増産用に杭州の新ウェーハ工場も建設しましたが、今後の販売戦略については、どのようにお考えでしょうか？

A8: 8インチウェーハについては、今後も、GlobalWafers とのパートナーシップを継続していくつもりです。技術の供与も同様です。但し、当社は中国国内で6インチ以下（小口径）の顧客への直接販売も手掛けており、中国国内の顧客については、（フットプリントや既存顧客ベースから）当社に一定の営業力も有る事もあり、既に直接営業活動を開始しています。これについては両社で協議の上での対応です。

尚、12インチウェーハの販売については、本提携の対象外ですので、当社が独自に進めてまいります。

尚、ある参加者の方から、現在、KPI として連結売上高、営業利益率などを提示していますが、今後、「1株当たり当期純利益」をKPIに追加しては如何でしょうか？という御提案も頂きました（事業会社と投資家との目線を合わせるという観点）。これについては、設定が実現可能か？も含めて、当社の今後の検討事項とさせていただきます。

※ 本資料は当社の「ディスクロージャーの方針」に基づき、「フェア・ディスクロージャー」の観点から、IR室 IR・広報部にて、まとめさせて頂きました。